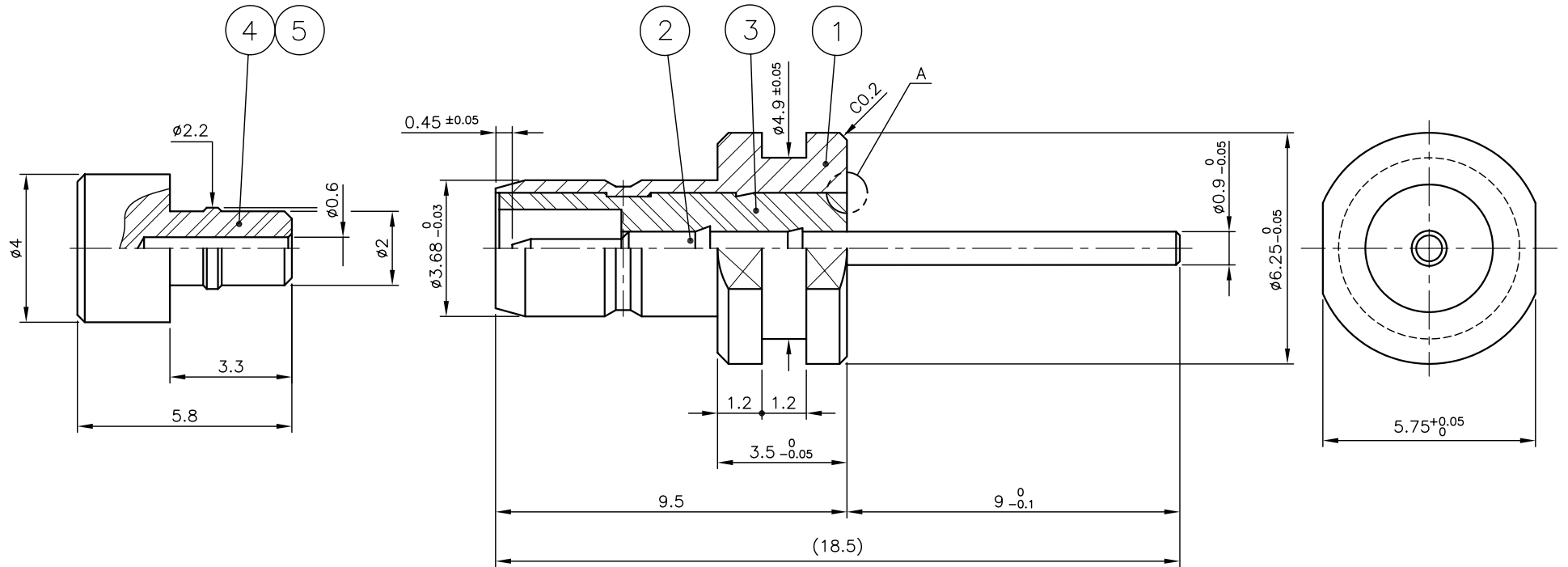


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	김인철	최영호	2010.07.29.



Note.

1. A부 BODY+TEFLON 조립 후 돌출 없을 것.
2. 제품의 외관에 이상이 없을 것.
3. 본 부품은 MS201-02를 만족 할 것.
4. 도금 사양 Ni Plate 염수분무 96시간 +24시간 방치
(ES96200-03 염수분무 시험 만족 할 것.)
5. 상대물과 삽입력과 이탈력
 - 삽입력 : 2~4kgf 이하
 - 이탈력 : 5~8kgf 이상

5	COVER	1	ACETAL	White	DCV00071-N/2
4	COVER	1	ACETAL	White	DCV00071-N/1
3	INSULATOR	1	TEFLON	White	DIN01430-N/1
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate 0.38μm	DCT02327-5/1
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate 5μm	DBD02336-5/2
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE 2010. 07. 29.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle	APPROVED BY	Y.H.CHOI	
MATERIAL	-	CHECKED BY		TITLE SMB50 SOLDER END JB (F/P)
		DRAWN BY	I.C.KIM	
FINISH	-	SCALE	6/1	DWG NO. CN02310-7/4 REVISION I R SHEET 1 of 1
		UNIT	mm	